



2026年3月18日

FUJI 株式會社

Fasford Technology 株式會社

FUJI 集團所屬 Fasford Technology 將在 SEMICON China 2026 全球首次公開新世代固晶機「XERDIA」

FUJI 株式會社（總部：日本愛知縣知立市，代表取締役社長：五十栖丈二，以下簡稱“FUJI”）所屬的從事半導體製造設備開發、製造與銷售的集團公司——Fasford Technology 株式會社（總部：日本山梨縣南阿爾卑斯市，代表取締役社長：粟生浩之，以下簡稱“Fasford Technology”），將於 **2026年3月25日（星期三）至27日（星期五）** 在上海舉辦的 SEMICON China 2026 上，全球首次公開展示其正在開發的新世代旗艦級固晶機「XERDIA」。



“固晶機（Die Bonder）”是一種半導體後段封裝設備，用於將積體電路晶片（Die）黏接（Bonding）到基板上。近年來，隨着半導體性能不斷提升以及儲存容量持續擴大，將多個晶片以高密度方式進行封裝的先進封裝技術的重要性不斷提高。在此類高密度封裝中，即使是極微小的晶片位置偏差也可能對產品可靠度產生重大影響，因此，高精度固晶技術變得至關重要。同時，以生成式 AI 為代表的資料處理需求迅速擴大，資料量呈爆發性成長，推動了資料中心及 AI 相關設備的快速普及，進而帶動以記憶體為核心的半導體需求持續成長。因此，半導體製程不僅需要更高精度，同時也對更高生產效率提出了更高要求。

為滿足上述市場需求，Fasford Technology 開發了新一代固晶機「XERDIA」。

「XERDIA」在延續傳統 DB830/DB850 系列設計理念的基礎上，對設備機台**結構、核心單元以及軟硬體控制平台**進行了全面革新，將固晶精度^{*}從 5 μ m 提升至 3 μ m，同時將生產效率^{*}從 UPH4,000 提升至 5,500，實現了躍進式性能提升。

此外，設備還延續了 DB 系列廣受好評的操作體驗，在實現高性能的同時，兼顧了使用者友善的操作性。

*根據本公司標準參數設定。

■ 四大開發理念

Fasford Technology 以“樹立新一代量產設備的行業新標準”為目標，在以下四大開發理念基礎上開發了「XERDIA」。

1. 穩定運轉 | 不停機

透過高剛性機台結構將震動降低 50%（與前代機型相比），並採用全新核心單元，使原本備受肯定的穩定運轉率進一步提升。

2. 縮短生產準備時間 | 省工時

透過新控制平台提升操作性，並導入自動工具更換功能與治具壓持機構通用化，使換線效率與維護效率最高提升 34%。

3. 最大化利用既有設備資產 | 高性價比

最大化運用 DB 系列既有資產（Tool、Recipe），進而實現初期投資成本極小化。

4. 降低環境負擔 | 更加環保

透過提升面積生產效率（較前代機型提升 30%）以及新控制平台帶來的能源效率提升，使設備待機時耗電量降低 13%；同時透過 ECO 模式 2.0，在設備閒置狀態下可進一步降低 26% 耗電量，減少環境負擔。

■ 加入 FUJI 集團後開發的首款全新設備

「XERDIA」是 Fasford Technology 自 2018 年加入 FUJI 集團以來，首次從零開始開發的全新設備。設備採用 FUJI Linear 株式會社製造的線性馬達，並與 FUJI 設計團隊共同完成設備設計，充分展現 FUJI 集團技術協同效應所帶來的全新設計理念。

■ SEMICON China 2026 展示資訊

在 2026 年 3 月 25 日（星期三）至 27 日（星期五）舉行的 SEMICON China 2026 展會期間，Fasford Technology 中國大陸代理商 JIPAL Corporation 將於 N4 館 4151 展位展示開發中的「XERDIA」設備，並將透過展會所獲得的市場反應用於後續產品優化。

此外，FUJI 株式會社亦將於 E4 館 4342 展位展示多項自動化解決方案，其中包括用於 SMT 製程[※]的電子元件貼裝機器人「NXTR」。

[※]指將電子元件安裝到電路板上的製造工序。

■ 未來規劃

上市計畫

「XERDIA」預計將於 2026 年 6 月正式上市。

Fasford Technology 將透過本次開發進一步強化在先進封裝領域的技術實力，創造新的市場價值。未來公司也將持續發揮 FUJI 集團的技術協同優勢，為半導體製造領域的技術創新作出貢獻。

■ 公司簡介

Fasford Technology 株式會社

公司名稱 : Fasford Technology 株式會社
代表人 : 代表取締役社長 栗生浩之
總部地址 : 〒400-0212 日本山梨縣南阿爾卑斯市下今諏訪 610-5
成立時間 : 2015 年 3 月
業務內容 : 半導體製造設備的設計、製造、銷售及維護服務
註冊資本 : 4 億 5050 萬日元
網址 : <https://www.fasford-tech.com/>

FUJI 株式會社

公司名稱 : FUJI 株式會社
代表人 : 代表取締役社長 五十栖丈二
總部地址 : 〒472-8686 日本愛知縣知立市山町茶碓山 19
成立時間 : 1959 年 4 月
業務內容 : 電子元件貼裝機器人及工具機的開發、製造與銷售
註冊資本 : 58 億 7800 萬日元
網址 : <https://www.fuji.co.jp/>

■ 聯絡方式

Fasford Technology 株式會社

官方網站諮詢入口

<https://www.fasford-tech.com/contact/>